

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2004-538504(P2004-538504A)

【公表日】平成16年12月24日(2004.12.24)

【年通号数】公開・登録公報2004-050

【出願番号】特願2003-515895(P2003-515895)

【国際特許分類】

**G 02 B 6/26 (2006.01)**

**G 02 B 26/00 (2006.01)**

**H 01 L 23/02 (2006.01)**

**H 01 L 27/14 (2006.01)**

【F I】

G 02 B 6/26

G 02 B 26/00

H 01 L 23/02 F

H 01 L 27/14 D

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月24日(2005.5.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光マイクロメカニカルデバイス用のパッケージにおいて、

基板の第1面に1つ以上の光マイクロメカニカルデバイスが設けられるダイであって、該第1面にダイ基準面を有するダイと、

前記ダイの第2面に取付けられるツーリングフィックスチャと、

開口部および該開口部の近傍のパッケージフレーム基準面を有するパッケージフレームであって、該パッケージフレーム基準面上に前記ダイ基準面を支持し、前記光マイクロメカニカルデバイスを該開口部内に配置するようになっているパッケージフレームと、

前記開口部に隣接して終端する1つ以上の光接続部位置合せ機構と、

前記光接続部位置合せ機構に配置され、1つ以上の前記光マイクロメカニカルデバイスに光学的に連結される1つ以上の光相互接続部の末端と、  
を具備することを特徴とするパッケージ。

【請求項2】

光マイクロメカニカルデバイスをパッケージングする方法において、

基板の第1面に1つ以上の光マイクロメカニカルデバイスが設けられるダイであって、該第1面にダイ基準面を有するダイを用意し、

前記基板の第2面にツーリングフィックスチャを取付け、

開口部および該開口部の近傍のパッケージフレーム基準面を有するパッケージフレームであって、該パッケージフレーム基準面上に前記ダイ基準面を支持し、前記光マイクロメカニカルデバイスを該開口部内に配置するようになっているパッケージフレームを用意し、

前記パッケージフレーム上の1つ以上の光接続部位置合せ機構であって、前記ダイ基準面が前記パッケージフレーム基準面上に係合するときに、前記ダイ上の対応する光マイクロメカニカルデバイスに対して位置合せされるように配置される光接続部位置合せ機構を用

意すること、  
を特徴とする方法。